

C23F 機械方法によらない表面からの金属質材料の除去（電食による金属加工 B 2 3 H；火炎の適用によるデサフェーシング B 2 3 K 7 / 0 0；レーザービームによる金属加工 B 2 3 K 2 6 / 0 0）；金属質材料の防食；鉍皮の抑制一般（電気分解もしくは電気泳動による金属表面の処理または金属への被覆 C 2 5 D，C 2 5 F）；少なくとも一工程はクラス C 2 3 に分類され，少なくとも一工程はサブクラス C 2 1 D もしくは C 2 2 F またはクラス C 2 5 に包含される金属質材料の表面処理の多段階工程 [4]

注

（ 1 ）このサブクラスは金属質または非金属質の表面であるか表面上であるかを問わず，下の注（ 2 ）を条件とする防食または鉍皮の抑制一般を包含する。

（ 2 ）このサブクラスは以下のものを包含しない：

保護層もしくは被覆組成物またはそれらの適用方法；これらは適切な箇所に分類される，例． B 0 5，B 4 4，C 0 9 D，C 1 0 M，C 2 3 C；

鉍皮の抑制のための機械，装置または特定物品の構造上の特徴；これらは適切な箇所に分類される，例．管または管取り付け具 F 1 6 L 5 8 / 0 0；

腐食あるいは鉍皮に対する耐性の面から選ばれた材料からできていることを特徴とする物品；これらは適切な箇所に分類される，例．タービン翼 F 0 1 D 5 / 2 8

サブクラス内の索引

エッチング，つや出し，それらの組成物 1/00, 3/00
金属質材料の他の除去 4/00
防食または鉍皮の抑制 11/00-15/00
多段階の表面処理 17/00

- 1/00 化学的手段による金属質材料のエッチング [2]
- 1/02 ・部分的エッチング
- 1/04 ・ケミカルミーリング
- 1/06 ・やすりの目立て
- 1/08 ・装置，例．写真製版
- 1/10 ・エッチング組成物（ C 2 3 F 1 / 4 4 が優先 ）[4]
- 1/12 ・ガス状組成物 [4]
- 1/14 ・水溶液組成物 [4]
- 1/16 ・酸性組成物（ C 2 3 F 1 / 4 2 が優先 ）[4]
- 1/18 ・銅または銅合金をエッチングするためのもの [4]
- 1/20 ・アルミニウムまたはアルミニウム合金をエッチングするためのもの [4]
- 1/22 ・マグネシウムまたはマグネシウム合金をエッチングするためのもの [4]
- 1/24 ・シリコンまたはゲルマニウムをエッチングするためのもの [4]
- 1/26 ・耐火金属をエッチングするための

もの [4]

- 1/28 ・鉄族金属をエッチングするためのもの [4]
- 1/30 ・その他の金属質材料をエッチングするためのもの [4]
- 1/32 ・アルカリ性組成物（ C 2 3 F 1 / 4 2 が優先 ）[4]
- 1/34 ・銅または銅合金をエッチングするためのもの [4]
- 1/36 ・アルミニウムまたはアルミニウム合金をエッチングするためのもの [4]
- 1/38 ・耐火金属をエッチングするためのもの [4]
- 1/40 ・その他の金属質材料をエッチングするためのもの [4]
- 1/42 ・水に混和しない液体を分散して含むもの [4]
- 1/44 ・異った組成の金属質材料の基板から金属質材料をエッチングするための組成物 [4]
- 1/46 ・エッチング組成物の再生 [4]
- 3/00 化学的手段による金属のつや出し [2]
- 3/02 ・軽金属
- 3/03 ・酸性溶液を用いるもの [4]
- 3/04 ・重金属
- 3/06 ・酸性溶液を用いるもの [4]
- 4/00 グループ C 2 3 F 1 / 0 0 または C 2 3 F 3 / 0 0 に分類されない，表面から金属質材料を除去するための方法 [4]
- 4/02 ・蒸発によるもの [4]
- 4/04 ・物理的分解によるもの [4]
- 11/00 腐食のおそれがある表面への抑制剤の適用または腐食媒体への抑制剤の添加による金属質材料の防食
- 11/02 ・蒸気状の抑制剤の空気またはガスへの添加
- 11/04 ・明白な酸性液体への添加
- 11/06 ・明白なアルカリ性液体への添加
- 11/08 ・他の液体への添加
- 11/10 ・有機質抑制剤を用いるもの

注

グループ C 2 3 F 1 1 / 1 2 ~ C 2 3 F 1 1 / 1 7 3 においては，ラストプレイス優先ルールが適用される，すなわち各階層レベルにおいて相反する指示がない限り，化合物は最後の適切な箇所に分類する。

- 11/12 ・酸素含有化合物
- 11/14 ・窒素含有化合物
- 11/16 ・硫黄含有化合物
- 11/167 ・りん含有化合物 [4]
- 11/173 ・高分子化合物 [4]
- 11/18 ・無機質抑制剤を用いるもの
- 13/00 陽極または陰極保護による金属の防食

C 2 3 F

- 13/02 ・陰極保護によるもの；陰極保護のための条件，変数または手順の選択，例．電氣的条件 [5]
- 13/04 ・希望の変数を制御または調整するもの [5]
- 13/06 ・陰極保護装置の構造的部分，または組み立て [5]
- 13/08 ・陰極保護による腐食の抑制に特に適した電極；その製造；その電極への電流の通電 [5]
- 13/10 ・構造に特徴のある電極 (C 2 3 F 1 3 / 1 6 が優先) [5]
- 13/12 ・素材に特徴のある電極 (C 2 3 F 1 3 / 1 6 が優先) [5]
- 13/14 ・犠牲陽極の素材 [5]
- 13/16 ・構造と素材の組み合わせに特徴のある電極 [5]
- 13/18 ・電極を支持する手段 [5]
- 13/20 ・電極への電流の通電 [5]
- 13/22 ・そのための監視装置 [5]
- 14/00 物理的または化学的目的のための液体加熱装置の銹皮の抑制 (スケール防止剤または除去剤の水への添加 C 0 2 F 5 / 0 0) [2]
- 14/02 ・化学的手段によるもの
- 15/00 他の方法による金属の防食または銹皮の抑制
- 17/00 少なくとも 1 工程はクラス C 2 3 に分類され，少なくとも 1 工程はサブクラス C 2 1 D もしくは C 2 2 F またはクラス C 2 5 に包含される金属質材料の表面処理の多段階工程 (メイングループ C 2 3 C 2 / 0 0 から C 2 3 C 2 6 / 0 0 の単一のメイングループに分類されない方法によるかまたはサブクラス C 2 3 C および C 2 5 D に分類される方法の組合わせによる少なくとも 2 以上の重ね合わせ被覆層を得るための被覆 C 2 3 C 2 8 / 0 0) [2 0 0 6 . 0 1]